

Semiconductor Talent Incubation Program Taiwan (STIPT)



Sechsmonatiges Studien- und Traineeship-Programm an einer taiwanischen Partneruniversität (Monate 1-4) und bei TSMC in Taichung (Monate 5-6), **September 2026 - Februar 2027**



BA-Studierende im 3. Jahr, **MA-Studierende** und **Diplom-Studierende** (mit mindestens der Hälfte der erbrachten Studienleistungen)



Studierende folgender Fächer: Elektrotechnik, Mikroelektronik, Nanoelektronik, Werkstoffkunde, Maschinenbau, Gerätetechnik, Automatisierungstechnik, Robotik, Sensortechnologie, Physik, Chemie



Teilnahmeberechtigte Universitäten: Sächsische Hochschulen, ForLab Universitäten, HAWtech Hochschulen

Reisekostenzuschuss: 1.500€
Lebenshaltungskostenzuschuss: 700€ (pro Monat)



Bewerbung:
15.11.25 -12.12.25

Programminfos:
[↗STIPT-Programm](#)



Bewerbungsportal:
[↗Direktlink zur Bewerbung](#)



Kontakt:
Leonardo-Sachsen

international.leosachsen@tu-dresden.de
Web: www.leo.tu-dresden.de

Semiconductor Talent Incubation Program Taiwan (STIPT)



Six-month study and traineeship program at a Taiwanese partner university (months 1-4) and at TSMC in Taichung (months 5-6), September 2026 - February 2027



BA students in their third year, **MA students** and **students in a diploma degree program** (if they have completed at least half of their course load)



Students who major in electrical engineering, microelectronics, nanoelectronics, materials science, mechatronics, mechanical engineering, equipment engineering, automation technology/ automation engineering, robotics, sensor technology, physics, chemistry



Participating universities: Sächsische Hochschulen, ForLab Universitäten, HAWtech Hochschulen

One-time travel assistance: 1.500€
Subsidy for living expenses: 700€ per month



Application period:
11/15/25 -12/12/25

Program details:
[↗STIPT-Program](#)

Application portal:
[↗Application Link](#)



Contact:
Leonardo-Sachsen

international.leosachsen@tu-dresden.de
Web: www.leo.tu-dresden.de